【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和4年12月8日(2022.12.8)

【国際公開番号】WO2021/230224
【出願番号】特願2022-521921(P2022-521921)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｐ　3/08(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｐ　3/08　２００

【手続補正書】
【提出日】令和4年10月24日(2022.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
第１接続電極１７１とグランド導体との間隔を広くするために、スリットを円形状にしてもよい。但し、スリットを円形状にすると、スリットの幅が広くなる。このため、電子部品２０の接続端子２１，２２の間隔が狭い場合、円形状のスリットより、円弧状の端部を有するスリットの方が好ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
《他の実施形態》
図１３、図１４、図１５、図１６、及び図１７は、他の実施形態に係る伝送線路の断面図である。図１３から図１７示すように、接続部１５１は、例えば、基板１１内に実装された電子部品や配線との不要な導通、結合、又は干渉を避けるため、第２主面Ｓ２側に迂回するように形成されてもよい。この場合、第１接続電極１７１は信号導体１３とグランド導体１４２の間に配置される。グランド導体１４２は、部分的に除かれ、第１接続電極１７１の少なくとも一部に重ならない。これにより、第１接続電極１７１とグランド導体１４２の間の容量結合が抑制される。